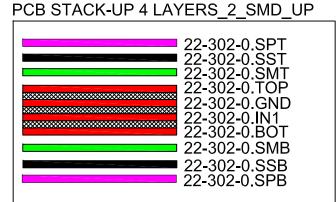


DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
×	0.200 mm		293	
+	0.800 mm		33	
₩	1.100 mm		34	
	1.200 mm		23	
0	1.300 mm		2	NON-PLATED
Δ	1.600 mm		2	
٥	2.700 mm		5	
TOTAL			392	



MATERIALE SUPPORTO SPESSORE RAME TIPOLOGIA CIRCUITO X LATI ESTERNI MONOFACCIA ∏ FR2 35u ☐ DOPPIA FACCIA X FR4 LATI INTERNI **M**MULTISTRATO SPESSORE SUPPORTO ALTRO N°LAYERS 1.6 mm TRATTAMENTI RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u RAME PASSIVATO MHOT AIR LEVELING \square DORATURA(D=140± \vee PN) □0.3u □0.6u □1,0u □1,3u □2,0u BISELLATURA NUMERO DEI CONTATTI DEPOSITO DI GRAFITE NUMERO DEI CONTATTI SOLDER RESIST **SERIGRAFIA** SERIGRAFICO Sp. X LATO COMP.COLORE BIANCO FOTOGRAFICO Sp. 13-100u XLATO SALD. COLORE BIANCO ☐ COVER LAYERSp. 25-76u TABELLA DEI FORI CON FILES DI DOCUMENTAZIONE LAVORAZ. PARTICOLARI ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE TIPO MET. N.MET. Q.TA' LAYER BOT **X** 22-302-0.BOT Α LAYER TOP **☒** 22-302-0.TOP В LAYER PWR С **X** 22-302-0.GND LAYER GND D X 22-302-0.SSB SERIG. BOT Е X 22-302-0.SST SERIG. TOP F X 22-302-0.IN1 LAYER IN1 G LAYER IN2 Н LAYER IN3 LAYER IN4 X 22-302-0.SMB L **RESIST BOT RESIST TOP** X 22-302-0.SMT М NOTE PARTICOLARI PAST BOT **X** 22-302-0.SPB PAST TOP **X** 22-302-0.SPT X 22-302-0.DRL LAYER FOR.

DRILL CHART

DRILL TAPE

MECC.DRW.

▼ 22-302-0.TAP

X 22-302-0.DWG



TUTTI I FORI NON

INDICATI DEVONO ESSERE METALLIZATI